

## **天津金海通半导体设备股份有限公司**

### **关于对外投资设立境外子公司的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、对外投资概述**

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司在马来西亚投资设立子公司，投资金额不超过500万美元（含本数），资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2023年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-019）。

#### **二、对外投资进展情况**

近日，公司已完成马来西亚子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

- 1、公司名称：JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.
- 2、注册号码：202301025284(1519207-T)
- 3、成立时间：2023年7月4日
- 4、组织形式：有限公司
- 5、经营范围：从事半导体测试设备的制造、进口、出口、经销、装配、维修、买卖等业务，并提供与半导体行业相关的研究、技术、科学和咨询服务。
- 6、注册资本：100 马来西亚令吉
- 7、注册地址：39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG MALAYSIA

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023年7月6日